

삼성전자, 세계최초 16단 MCP 개발

10단 MCP보다 30% 작은 패키지에 16개 칩 탑재 ... 2006년 35% 점유

삼성전자는 11월1일 세계 최초로 16개의 메모리 반도체를 1개의 패키지(Package)에 탑재한 16단 MCP(Multi Chip Package)를 개발했다고 밝혔다.

16단 MCP는 현재 양산중인 최대 용량 메모리인 8기가비트(Gb) 낸드플래시 16개를 적층해 16기가바이트(GB) 용량을 구현한 제품으로 삼성전자는 2005년 개발한 10단 MCP보다 크기가 30% 가량 작은 패키지에 16개의 칩을 쌓았다고 덧붙였다.

이로써 삼성전자는 2003년 6단 MCP를 개발한 이후 2004년 8단 MCP, 2005년 10단 MCP에 이어 2006년 16단 MCP까지 4년 연속 칩 적층 기술 개발을 선도하게 됐다.

휴대전화를 중심으로 모바일 디지털 기기가 한층 소형화하고 다기능화함에 따라 대용량 탑재와 동시에 여러 종류의 메모리 반도체를 하나의 패키지에 묶어 기능을 다양화시킨 MCP의 수요는 점차 확대되고 있는 추세이다.

삼성전자는 MCP를 구성하는 메모리 토털 솔루션을 보유한 유일기업으로 2004년 처음으로 MCP 시장에서 세계 1위에 올랐으며, 2006년에도 35% 이상의 점유율로 3년 연속 1위 수성이 유력시되고 있다.

삼성전자 관계자는 “현재 8단 적층 수준에 머물고 있는 경쟁기업들에 비해 2년 정도 앞선 기술을 보유하게 돼 차세대 패키지 분야의 리더십도 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다”고 강조했다. (서울=연합뉴스) 강영두 기자 <저작권자(c)연합뉴스-무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2006/11/01>